

# 銅ベース基板(キャビティ構造)

## 1. 製品概要

銅ベース基板(キャビティ構造)は、高放熱性・高精度な配線技術を活かし、先端技術分野での高性能電子部品の実装に最適なソリューションを提供します。本製品は、パワーデバイスや高周波モジュール向けに特化し、熱管理性能と電気的特性を最大限に向上させています。

## 2. 特長

### 優れた放熱性能

銅ベースを採用することで従来の基板よりも高い熱伝導率を実現し電子部品の発熱を効果的に管理。

### 高精度キャビティ構造

基板内部に精密なキャビティ(凹部)を形成することで、半導体チップの埋め込み実装が可能。

### 低インピーダンス設計

電氣的損失を最小限に抑え、高周波特性を向上。

### 多用途対応

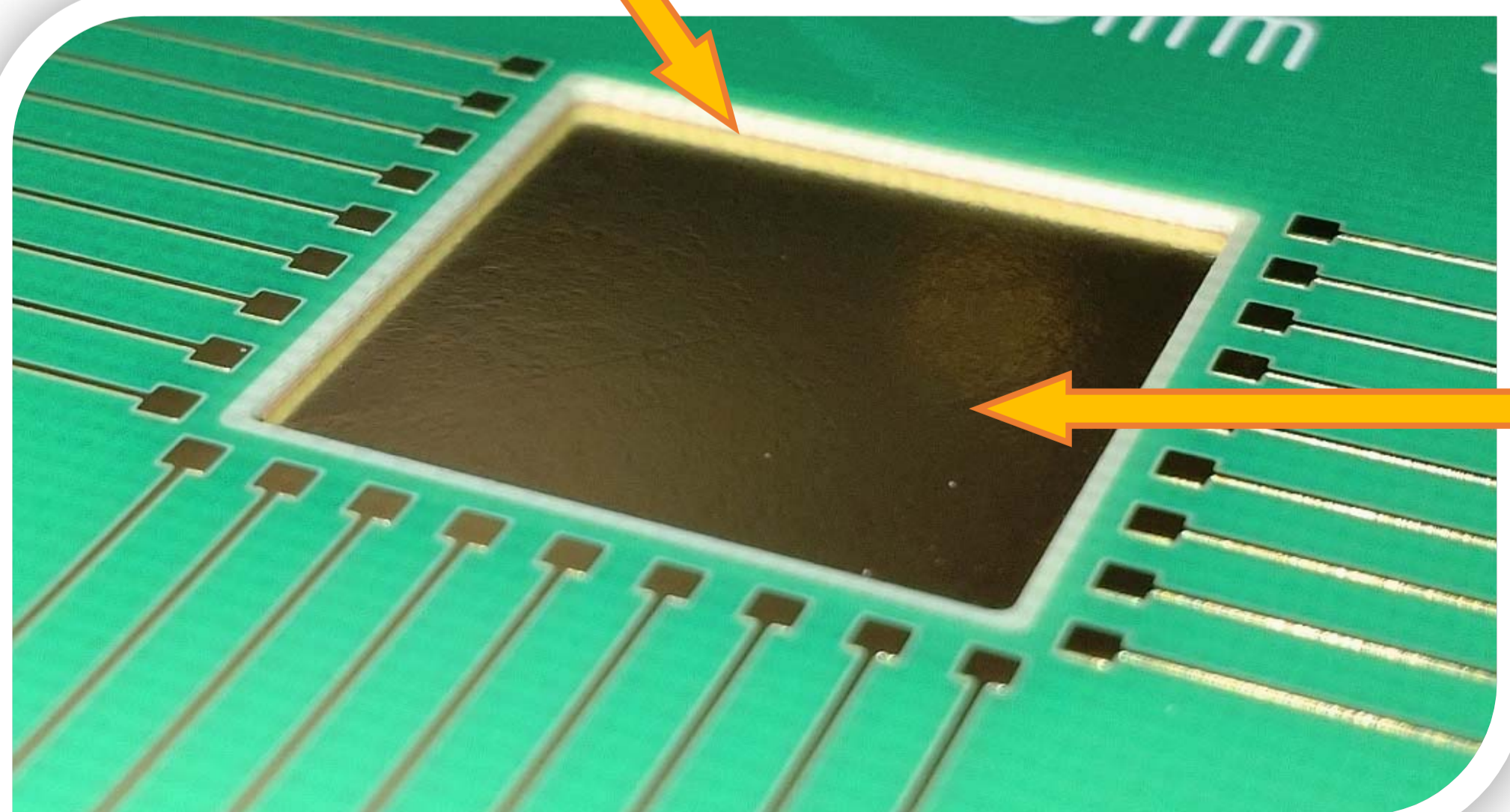
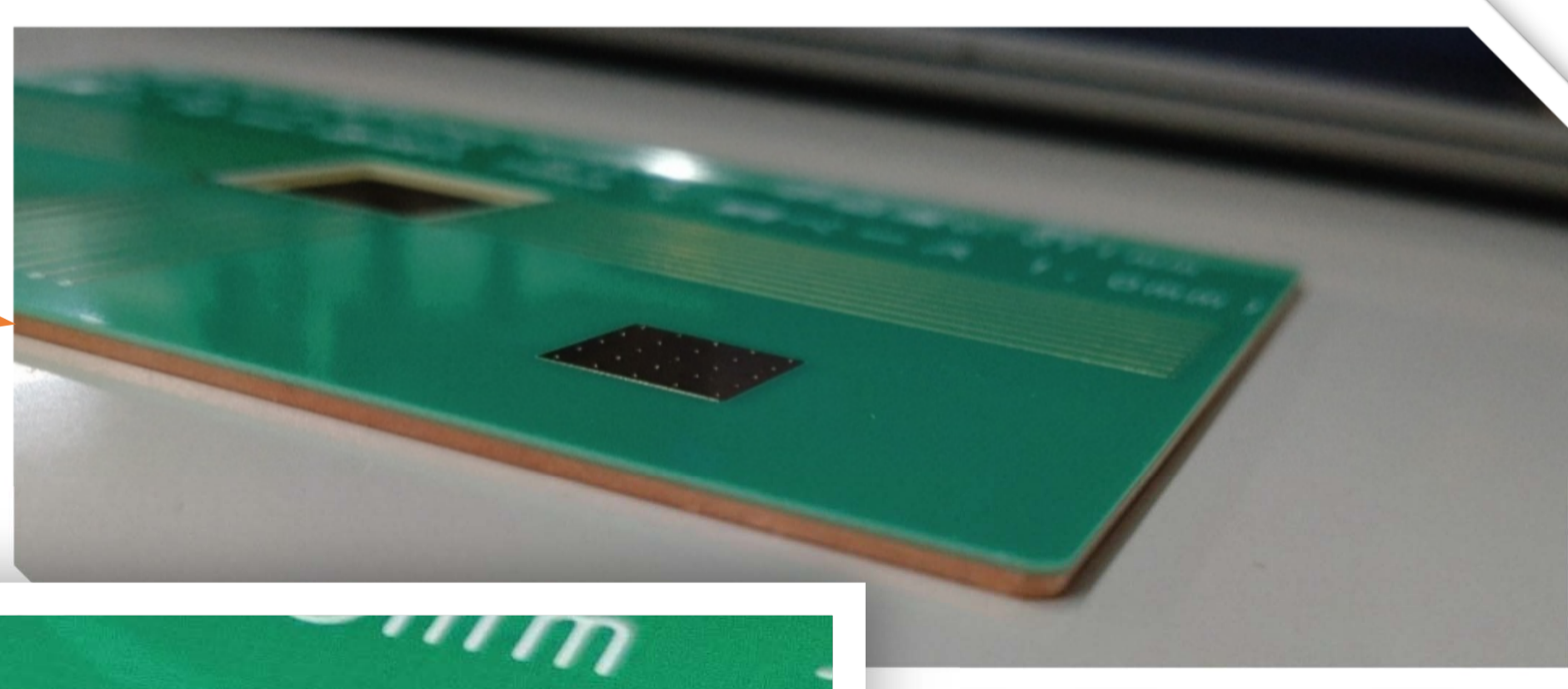
パワーモジュール、5G通信機器、レーザー機器、車載電子機器など幅広い用途に適用可能。

## 3. 製品画像

以下の写真は、銅ベース基板(キャビティ構造)の実際のサンプルです。

銅ベース

キャビティ(凹)構造



平坦度

0.011mm

## 4. 層構成

【銅ベース基板（キャビティ構造） 層構成表】

層構成表				基材	FR-4+銅板
層数	2	板厚	1.79	仕様	貫通樹脂埋め(蓋メッキ有)
層構成/種類					
				レジスト	0.020
L1				Cu	0.035
				コア	0.560
				Cu	0.000
				PP	0.140
L2				銅板	1.035
					1.790

(a) 平坦度0.011mm

- ◆FR-4 + Cuベース基板(1mm)
- ◆導通ホールは樹脂埋め仕様 (Φ0.3仕上り)
- ◆表面処理はボンディング金メッキ



## 5. 応用例

- ・パワーモジュール：高電力対応の放熱性向上
- ・5G・高周波デバイス：低損失・高周波対応
- ・車載用電子部品：耐久性・信頼性の向上

## 6. まとめ

銅ベース基板(キャビティ構造)は、次世代の電子デバイスに最適な高性能基板です。高い放熱性能と精密なキャビティ加工により、従来の基板では実現できなかった高性能・高信頼性のソリューションを提供します。

貴社の具体的なニーズに合わせたカスタマイズ対応も可能です。

詳細仕様やご相談は、お気軽にお問い合わせください。